

半導體工程系 進四技 108 學年度入學課程結構規劃表

課程類別		一年級						二年級						三年級						四年級					
		第一學期			第二學期			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期		
		課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數
校共同必修課程	應修學分數 10 學分	實務應用文	2	2	大學國語文	2	2																		
		實用英文(一)	2	2	實用英文(二)	2	2	實用英文(三)	2	2															
		體育(一)	0	2	體育(二)	0	2	體育(三)	0	2	體育(四)	0	2												
通識課程	博雅通識 應修學分數 10 學分 (每課群 必修 1 門)	美感與人文素養	博雅通識/學分數/時數																						
		科技與環境永續	博雅通識/學分數/時數																						
		社會與知識經濟	博雅通識/學分數/時數																						
		歷史與多元思維	博雅通識/學分數/時數																						
		全球與未來趨勢	博雅通識/學分數/時數																						
跨課群認列		通識微學分(一)1、通識微學分(二)1																							
專業課程	必修 應修課程數 23 門/ 應修學分數 69 學分	微積分(一)	3	3	微積分(二)	3	3	電子學(一)	3	3	電子學(二)	3	3	半導體元件	3	3	微電子專題	3	3	單晶片實驗	3	3			
		電路學(一)	3	3	電路學(二)	3	3	工程數學	3	3	半導體材料概論	3	3	半導體製程	3	3	FPGA/HDL 設計實習	3	3						
		普通物理	3	3	電路應用實務	3	3	微電子電路實驗	3	3	程式語言實習	3	3	電磁學	3	3									
		普通物理實驗	3	3	數位邏輯實務	3	3	電腦輔助 電路設計實習	3	3	計算機概論 (Office 軟體應用)	3	3												
											微電子應用 電路實驗	3	3												
專業課程	選修 應修學分數 至少選修 39 學分												半導體量測實驗	3	3	統計學	3	3	自動控制	3	3	VLSI 設計	3	3	
													數位系統 應用實務	3	3	真空系統	3	3	感測元件應用 電路實習	3	3	數位訊號處理	3	3	
													IC 產業 介紹與應用	3	3	物聯網產業 介紹與應用	3	3	感測網路 應用實務	3	3	半導體 無塵室技術	3	3	
													太陽能光電技術	3	3	虛擬圖控 儀表實務	3	3	發光二極體 元件及其應用	3	3	光電元件量測 暨封裝實務	3	3	
													半導體封裝工程	3	3	嵌入式系統實習	3	3	半導體構裝材料 與製程簡介	3	3	半導體封裝元件 EMI/EMC 分析	3	3	

備註：

一、畢業總學分數為 128 學分。

二、專業課程必修 69 學分，專業課程選修 39 學分。(不含校共同必修課程及通識課程的學分數)

三、校共同必修課程及通識課程 20 學分；相關規定依據本校「共同教育課程實施辦法」、「共同教育課程結構規劃表」及「語言教學實施要點」。

四、系所訂定條件(學程、檢定、證照、承認外系學分及其他)：承認外系選修學分 9 學分為專業選修(本院非本系開設之專業選修課程至多承認 6 學分，非本院開設之專業選修課程至多承認 3 學分)

